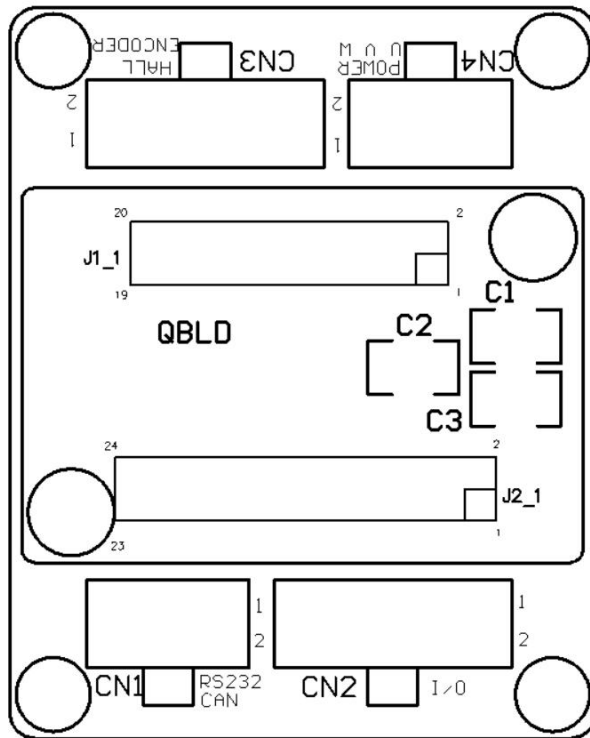


PCB 焊接工艺要求	产品名称	产品型号	工序	版本	页数	制订时间
	直流伺服	DGFLY-INTERFACE_V1	焊接	V1	1	2022-4-24



名称	型号	规格参数	品牌	位号
贴片电容	10UF/100V	1812 ±10%	国巨	C1, C2, C3
黑色双排插座	小5566-2*3P针	3.0-2*3P/直插/黑色插座	科发	CN1, CN4
黑色双排插座	小5566-2*5P针	3.0-2*5P/直插/黑色插座	科发	CN2, CN3
贴片排母	2.54*5.0排母2*10P/SMT/U型/PA6T/W=7.4	SMT-2.54-2*10P (高度5mm)	联益	J1_1
贴片排母	2.54*5.0排母2*12P/SMT/U型/PA6T/W=7.4	SMT-2.54-2*12P (高度5mm)	联益	J2_1
线路板	QBLD 测试基座板		MOTEC	

要求:

1. 线路板对应元件表进行焊接;
2. 所有元器件均紧贴线路板焊接
3. 贴片插座要对齐中心位置, 偏差要小于 0.2mm, 否则影响板子插接
4. 手工操作要做防静电处理
5. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	